

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2025-053

华维设计集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☒ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 5 月 9 日（周五）15:00-17:00

活动地点：中证路演中心（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）

参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：董事长廖宜勤先生；董事、总经理廖宜强先生；财务负责人、董事会秘书侯昌星先生；保荐代表人刘俊杰先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公

司在年度报告业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复。主要问题及回复如下：

问题 1：请问董事长，公司收购半导体业务后，未来发展思路是否是半导体叠加工程设计两轮驱动？将如何支持实现协调发展？华维芯微电子是否具有 3D 封装技术？是否有封装堆叠技术？未来发展思路是什么？今年上半年半导体业务业绩情况如何？半导体业务订单是否充足？

回答：尊敬的投资者，您好。2024 年度，公司主营业务仍以工程设计业务为主。2025 年初，公司通过购买九江华维芯 51%股权进入集成电路领域，公司将坚持实施“差异化”经营战略，大力开发主业市场，在低风险低成本的前提下，探索发展新的利润增长点。公司在江西省内积累有一定的政府资源、客户资源，公司将进一步发挥上市公司平台优势，协助九江华维芯拓展客户资源，积极开拓业务；同时，协助九江华维芯完善员工管理体系，实施更具有吸引力的人才激励措施，提升研发能力。

九江华维芯集成电路封装测试业务，可实现磨片、划片、上片、打线、电镀、塑封、切筋、打标、测试、编带等集成电路封装测试工艺流程，涵盖 SOP、SOT、QFN 等封装形式。目前，九江华维芯生产经营活动正常有序，涉及后续经营安排，公司将会按照相关规定履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题 2：近期公司是否中标重大合同？公司应收账款今年上半年能否改善？国家化债对公司债务有何影响？上半年公司设计业务是否充足？

回答：尊敬的投资者，您好。公司目前生产经营活动正常有序。公司强化经营性回款管理，加强与客户的沟通，跟踪客户经营动态，安排专人定期催收，必要时采取一切合法措施，努力维护公司权益。国家化债政策，预计对公司应收账款的催收及对潜在新项目的启动有一定的积极正面影响。有关半年度业务情况，请投资者关注公司后续定期报告。感谢您的关注。

问题 3：未来是否有继续收购国内上下游产业链相关企业的计划？

回答：尊敬的投资者，您好。公司坚持实施“差异化”经营战略，大力开发主业市场，在低风险低成本的前提下，探索发展新的利润增长点。公司未来如有相关事项，将按照北京证券交易所股票上市规则的要求，履行相关审议和信息披露程序，感谢您的关注。

问题 4：公司是否有回购股份计划？如何搞好市值管理工作？

回答：尊敬的投资者，您好。公司目前暂无回购股份计划，如有相关安排或计划，将按法律法规的有关要求及时履行信息披露义务。公司高度重视市值管理工作，将持续优化信息披露质量，继续做好投资者关系管理的各项工作。同时，公司管理层将努力提升公司盈利能力和公司治理水平，持续推动企业经营的高质量发展，争取以良好的业绩来回馈广大投资者。感谢您的关注。

问题 5：请问今年 2024 年度现金分红政策是基于哪方面考虑？

回答：尊敬的投资者，您好。公司本次权益分派拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。此利润分配预案是充分考虑在满足公司 2025 年度经营和资金需求的情况下制定的。公司利润分配政策符合证监会以及北交所相关政策要求，遵从《公司章程》的规定和公司的实际情况，该事项尚需公司 2024 年年度股东会审议，相关进展请查阅公司相关公告。感谢您的关注。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日